

## Presseinformation

**PolyIC GmbH & Co. KG: 22.05.2009**

### **Spitzentechnologie von PolyIC auf dem „Gipfeltreffen“ der organischen Elektronik**

**Fürth, Deutschland:** Die LOPE-C 2009 ([www.lope-c.com](http://www.lope-c.com)) ist die weltgrößte und bedeutendste Konferenz- und Messeveranstaltung im Bereich der organischen Elektronik. Als Gold-Sponsor dieses interdisziplinären „Gipfeltreffens“, welches vom 23. bis 25. Juni in Frankfurt am Main stattfindet, wird die Firma PolyIC dort mehrere innovative Anwendungen live und exklusiv zeigen.

Zahlreiche Teilnehmer aus aller Welt werden als Gäste der OE-A (Organic Electronics Association), die ihrerseits dem Dachverband VDMA (Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer) angehört, in den Frankfurter Messehallen erwartet. Mehr als 50 ausstellende Firmen und über 100 angekündigte Präsentationen bieten dort dem interessierten Fachpublikum umfassend Gelegenheit, sich aus erster Hand über den neuesten Stand von Forschung und Entwicklung zu informieren.

Ein Highlight der LOPE-C 2009 werden die technischen Vorträge sein, die für den 24. und 25. Juni auf der Agenda stehen. Bei dieser Gelegenheit wird PolyIC zum ersten Mal wettbewerbsrelevante technische Daten zum Druckprozess und zur Rolle-auf-Rolle-Produktion bekanntgeben. Bereits am 23. Juni erläutert der Technologieführer im Rahmen der Business Conference seine aktuelle strategische Ausrichtung.

Spitzentechnologie aus Deutschland ist beileibe kein Schlagwort von gestern: PolyIC zeigt weltweit erstmalig eine echte Produktionsrolle, die gedruckte RFID-Transponder enthält. Indes findet der Fortschritt heute längst nicht mehr nur in den

Laboren statt: Praxisnahe und aktuelle Anwendungsbeispiele demonstrieren höchst anschaulich die vielfältigen Einsatzfelder gedruckter Elektronik-Etiketten. Besucher früherer Veranstaltungen, die die mit RFID-Gutscheinkarten berührungslos bedienbare PolyIC-Kaffeemaschine schon kennen, werden von deren Fortentwicklung überrascht sein...

## **PolyIC GmbH & Co. KG**

PolyIC ist führend in der Entwicklung von Polymerelektronik-Bauteilen und überdies Anbieter von Produkten und Komponenten mit gedruckter Elektronik aus organischen bzw. druckbaren Halbleitern. Die beiden Produktlinien heißen PolyID® und PolyLogo®. Die Aktivitäten fokussieren sich auf die Bereitstellung innovativer Low-Cost Elektronik-Produkte für den Massenmarkt.

PolyIC setzt auf die im eigenen Haus vorhandene Materialkompetenz, auf neu adaptierte Methoden des Chip-Designs sowie auf bewährte Prozesse der Massenproduktion (z.B. Rollendruck), um diese neue Technologie zu entwickeln und bis zur Großserienreife voranzutreiben. Leitapplikation ist RFID (Radio Frequency Identification): Die drahtlose Datenauslesung hat das Potential, zukünftig flächendeckend in vielerlei Anwendungsbereichen eingesetzt zu werden, die nach sehr dünnen und flexiblen Elektronik-Komponenten zu vernachlässigbaren Stückkosten verlangen.

PolyIC ist Mitglied der EPCglobal (einer weltweit aufgestellten Organisation zur RFID-Standardisierung) sowie der OE-A (Organic Electronics Association), des internationalen Verbandes zur Förderung organischer Elektronik. Seit dem Jahr 2008 ist PolyIC zudem Mitglied im AIM-D e.V., des Fachverbandes für automatische Identifikation, Datenerfassung und mobile Datenkommunikation.

Bereits im November 2003 wurde die PolyIC GmbH & Co. KG als Joint Venture zwischen Leonhard Kurz (51%, Beschichtungen und Heißprägetechnologie) und Siemens (49%, Elektronik) für Entwicklung und Produktion gedruckter Polymerelektronik gegründet. Zwischen Erlangen und Nürnberg im fränkischen Fürth angesiedelt, hat das Unternehmen auf dem Firmengelände der Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG seinen Sitz.

Den Internet-Auftritt von PolyIC finden Sie unter [www.polyic.com](http://www.polyic.com).

Aussagekräftige Bilder zum Thema sind in druckfähiger Qualität unter [www.polyic.de/de/presse-bilder.php](http://www.polyic.de/de/presse-bilder.php) verfügbar.



Heiße Sache: Berührungslose Bedienungskonzepte mit elektronischen Gutscheinkarten